

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 1 月 26 日 (2006.1.26)

【公開番号】特開 2004-260204 (P2004-260204A)

【公開日】平成 16 年 9 月 16 日 (2004.9.16)

【年通号数】公開・登録公報 2004-036

【出願番号】特願 2004-128145 (P2004-128145)

【国際特許分類】

H 0 1 L 21/31 (2006.01)

H 0 1 L 21/3065 (2006.01)

C 2 3 C 16/44 (2006.01)

【F I】

H 0 1 L 21/31 B

H 0 1 L 21/302 1 0 1 H

C 2 3 C 16/44 J

【手続補正書】

【提出日】平成 17 年 12 月 1 日 (2005.12.1)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

反応管と、

流量制御バルブを介して供給される所望のガスを前記反応管内に導入する、前記反応管の長手方向に延在するガス導入管であって、多数の孔を設けた前記ガス導入管と、前記反応管内の雰囲気を排気するガス排気管であって、閉塞部材を有した前記ガス排気管と、

複数の基板を支持可能な基板支持体と、

少なくとも前記流量制御バルブと前記閉塞部材を制御する制御部と、を備え、

前記制御部は、少なくとも前記流量制御バルブと前記閉塞部材を制御することにより、前記孔から前記基板支持体を収容した前記反応管内にクリーニングガスを導入する前の所定時点から、前記反応管内にクリーニングガスを導入開始から数秒経過する時点までに、排気を実質的に停止させるよう制御し、

前記反応管内にクリーニングガスを導入後、前記反応管内の圧力が 10 Torr 以上となるまで前記クリーニングガスを充満させる第 1 段階と、前記第 1 段階の後に前記反応室内をベース圧力まで排気する第 2 段階とを、少なくとも 1 サイクル以上繰り返すよう制御することを特徴とする基板処理装置。